

上海晶丰明源半导体股份有限公司

关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金

报告书（草案）修订说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海晶丰明源半导体股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金方式购买四川易冲科技有限公司 100%股权，同时募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

公司于 2026 年 1 月 9 日收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的《关于上海晶丰明源半导体股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的审核中心意见落实函》（上证科审（并购重组）〔2026〕1 号）（以下简称“《落实函》”）。根据《落实函》及上交所进一步的审核意见，公司会同相关中介机构认真落实，形成了《上海晶丰明源半导体股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（上会稿）》（以下简称“《重组报告书（上会稿）》”）。

相较公司于 2025 年 12 月 16 日披露的《上海晶丰明源半导体股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）》（以下简称“《重组报告书（修订稿）》”），《重组报告书（上会稿）》主要修订情况如下（如无特别说明，本公告中的简称或释义均与重组报告书中“释义”所定义的词语或简称具有相同的含义）：

章节	修订情况
重大事项提示	更新本次交易对中小投资者权益保护的安排，更新本次交易已履行的决策程序和批准情况，新增标的公司财务报告截止日后经营情况，新增模拟芯片行业周期性波动的风险
第一章 本次交易概况	更新本次交易已履行的决策程序和批准情况
第三章 交易对方基本情况	更新交易对方存续期与锁定期匹配情况
第九章 管理层讨论与分析	新增标的公司财务报告截止日后经营情况，更新上市公司对拟购买资产的整合管控安排

章节	修订情况
第十二章 风险因素分析	新增“受模拟芯片行业周期影响，标的公司收入增速放缓的风险”

除上述更新修订内容外，公司已对《重组报告书（上会稿）》全文进行了梳理和自查，对本次交易方案无影响。

特此公告。

上海晶丰明源半导体股份有限公司

董 事 会

2026 年 1 月 10 日